



概述

应用

DS2788用于测量可充电锂离子电池(Li+)和Li+聚合物电池 的电压、温度及电流,估算电池的可用电量。计算电量所 需的电池包参数和应用参数存储在片上EEPROM中。根据 电量寄存器的内容,向主机报告在当前温度、放电速率、 存储电荷以及应用参数下,剩余电量的保守估计。剩余 电量计算值以毫安时和满容量的百分比表示。

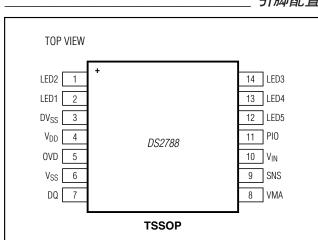
LED显示驱动器和去抖动输入简化了电池容量的信息显示。 LED引脚可以直接吸入电流,仅需一个电阻设置LED电流, 从而节省了空间和成本。

电动工具
电动自行车
电动车辆
不间断电源
数码相机

\_\_ 特性

DS2

- ◆ 5个30mA开漏输出用于驱动LED电量显示器
- ◆ 去抖动电量计显示使能控制
- ◆ 内置电压检测增益设置电阻, 省去了外部分压器
- ◆ FET驱动引脚只在电压测量期间开启分压器, 节省功耗
- ◆ 高精度电压、温度、电流测量系统
- ◆ 高精度、具有高温度稳定性的内部时基
- ◆根据库伦计数、放电速率、温度和电池特性估计绝对 和相对电量
- ◆ 精确的低电池电压报警检测
- ◆ 自动将库伦计数值和使用寿命估计备份到非易失(NV) EEPROM
- ◆ 具有增益和温度系数校准, 允许采用低成本检测电阻
- ◆ 24字节电池/应用参数EEPROM
- ◆ 16字节用户EEPROM
- ◆ 唯一ID和多点1-Wire<sup>®</sup>接口
- ◆ 14引脚TSSOP封装



定购信息

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE
DS2788E+	-25°C to +70°C	14 TSSOP
DS2788E+T&R	-25°C to +70°C	14 TSSOP

+表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装。 T&R = 卷带包装。

典型工作电路在数据资料的最后给出。

1-Wire是Maxim Integrated Products, Inc.的注册商标。

本文是英文数据资料的译文,文中可能存在翻译上的不准确或错误。如需进一步确认,请在您的设计中参考英文资料。 有关价格、供货及订购信息,请联络Maxim亚洲销售中心: 10800 852 1249 (北中国区),10800 152 1249 (南中国区), 或访问Maxim的中文网站: china.maximintegrated.com。

### 引脚配置



## **ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS**

Voltage Range on Any Pin Relative to VSS	-0.3V to +6.0V
Voltage Range on VIN, VMA Relative to VSS .	0.3V to V <sub>DD</sub> + 0.3V
DV <sub>SS</sub> to V <sub>SS</sub>	-0.3V to +0.3V
LED1-5	60mA each pin

Operating Temperature Range .....-40°C to +85°C Storage Temperature Range .....-55°C to +125°C Soldering Temperature (10s) .....Refer to IPC/JEDEC-020 Specification.

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

## **RECOMMENDED DC OPERATING CHARACTERISTICS**

 $(V_{DD} = 2.5V \text{ to } 4.5V, T_A = -25^{\circ}C \text{ to } +70^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted. Typical values are at T_A = +25^{\circ}C.)$ 

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	ТҮР	MAX	UNITS
Supply Voltage	V <sub>DD</sub>	(Note 1)	+2.5		+4.5	V
V <sub>IN</sub> , VMA Voltage Range		(Note 1)	0		V <sub>DD</sub>	V
DQ, PIO, OVD, LED1-LED5 Voltage Range		(Note 1)	0		+5.5	V

## **DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

 $(V_{DD} = 2.5V \text{ to } 4.5V, T_A = -25^{\circ}C \text{ to } +70^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted. Typical values are at }T_A = +25^{\circ}C.)$ 

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	ТҮР	MAX	UNITS
ACTIVE Current		$2.5V \le V_{DD} \le 4.2V$		70	95	
	IACTIVE				105	μA
SLEEP Mode Current	ISLEEP			1	3	μA
Input Logic-High: DQ, PIO	VIH	(Note 1)	1.5			V
Input Logic-Low: DQ, PIO	VIL	(Note 1)			0.6	V
Output Logic-Low: DQ, PIO, VMA	Vol	I <sub>OL</sub> = 4mA (Note 1)			0.4	V
Output Logic-High: VMA	V <sub>OH</sub>	I <sub>OH</sub> = 1mA (Note 1)	V <sub>DD</sub> - 0.5			V
VMA Precharge Time	t <sub>PRE</sub>		13.3		14.2	ms
Pulldown Current: DQ, PIO	IPD	$V_{DQ}, V_{PIO} = 0.4V$		0.2	5	μA
Output Logic-Low: LED1–LED5	Vol	I <sub>OL</sub> = -30mA (Note 1)			1	V
Input Logic-High: OVD	VIH	(Note 1)	V <sub>DD</sub> - 0.2			V
Input Logic-Low: OVD	VIL	(Note 1)			V <sub>SS</sub> + 0.2	V
VIN Input Resistance	R <sub>IN</sub>		15			MΩ
DQ SLEEP Timeout	tSLEEP	DQ < V <sub>IL</sub>	1.8	2.0	2.2	s
Undervoltage SLEEP Threshold	VSLEEP	(Note 1)	2.40	2.45	2.50	V
PIO Switch Debounce			100		130	ms
LED1 Display Blink Rate		50% duty cycle	0.9	1.0	1.1	Hz
LED Display-On Time			3.6	4.0	4.4	S



## ELECTRICAL CHARACTERISTICS: TEMPERATURE, VOLTAGE, CURRENT

 $(V_{CC} = 2.5V \text{ to } 4.5V, T_A = -25^{\circ}C \text{ to } +70^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted. Typical values are at }T_A = +25^{\circ}C.)$ 

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	ТҮР	MAX	UNITS
Temperature Resolution	T <sub>LSB</sub>			0.125		°C
Temperature Error	T <sub>ERR</sub>				±3	°C
Voltage Resolution	V <sub>LSB</sub>			4.88		mV
Voltage Full-Scale	VFS		0		4.5	V
Voltage Error	VERR				±50	mV
Current Resolution	I <sub>LSB</sub>			1.56		μV
Current Full-Scale	IFS				±51.2	mV
Current Gain Error	IGERR	(Note 2)			±1	% Full Scale
Current Offset Error	IOERR	$\begin{array}{l} 0^{\circ}C \leq T_{A} \leq +70^{\circ}C, \ 2.5V \leq V_{DD} \leq 4.2V \\ (Notes \ 3, \ 4) \end{array}$	-7.82		+12.5	μV
Accumulated Current Offset	qoerr	$\begin{array}{l} 0^{\circ}C \leq T_{A} \leq +70^{\circ}C, \ 2.5V \leq V_{DD} \leq 4.2V, \\ V_{SNS} = V_{SS} \ (Notes \ 3, \ 4, \ 5) \end{array}$	-188		0	µVhr/ day
		$V_{DD} = 3.8V, T_A = +25^{\circ}C$			±1	
Timebase Error	terr	$0^{\circ}C \leq T_A \leq +70^{\circ}C, \ 2.5V \leq V_{DD} \leq 4.2V$			±2	%
					±3	

## **ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 1-Wire INTERFACE, STANDARD**

 $(V_{CC} = 2.5V \text{ to } 4.5V, T_A = -25^{\circ}C \text{ to } +70^{\circ}C.)$ 

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	ТҮР	MAX	UNITS
Time Slot	tslot		60		120	μs
Recovery Time	trec		1			μs
Write-0 Low Time	tLOWO		60		120	μs
Write-1 Low Time	tLOW1		1		15	μs
Read Data Valid	t <sub>RDV</sub>				15	μs
Reset-Time High	tristh.		480			μs
Reset-Time Low	trstl		480		960	μs
Presence-Detect High	tPDH		15		60	μs
Presence-Detect Low	tPDL		60		240	μs



## ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 1-Wire INTERFACE, OVERDRIVE

 $(V_{CC} = 2.5V \text{ to } 4.5V, T_A = -25^{\circ}C \text{ to } +70^{\circ}C.)$ 

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	ТҮР	МАХ	UNITS
Time Slot	<b>t</b> SLOT		6		16	μs
Recovery Time	t <sub>REC</sub>		1			μs
Write-0 Low Time	tLOWO		6		16	μs
Write-1 Low Time	tLOW1		1		2	μs
Read Data Valid	t <sub>RDV</sub>				2	μs
Reset-Time High	t <sub>RSTH</sub>		48			μs
Reset-Time Low	<b>t</b> RSTL		48		80	μs
Presence-Detect High	t <sub>PDH</sub>		2		6	μs
Presence-Detect Low	<b>t</b> PDL		8		24	μs

## **EEPROM RELIABILITY SPECIFICATION**

 $(V_{CC} = 2.5V \text{ to } 4.5V, T_A = -25^{\circ}C \text{ to } +70^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted. Typical values are at }T_A = +25^{\circ}C.)$ 

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	ΤΥΡ	МАХ	UNITS
EEPROM Copy Time	tEEC				10	ms
EEPROM Copy Endurance	NEEC	$T_A = +50^{\circ}C$ (Note 6)	50,000			Cycles

Note 1: All voltages are referenced to VSS.

Note 2: Factory-calibrated accuracy. Higher accuracy can be achieved by in-system calibration by the user.

**Note 3:** Parameters guaranteed by design.

Note 4: At a constant regulated V<sub>DD</sub> voltage, the Current Offset Bias register can be used to obtain higher accuracy.

Note 5: Accumulation Bias register set to 00h.

**Note 6:** EEPROM data retention is 10 years at +50°C.

引脚说明

引脚	名称	功能
1	LED2	显示器驱动,连接至与V <sub>DD</sub> 相连的LED,用于显示电池包的相对电量。
2	LED1	显示器驱动,连接至与V <sub>DD</sub> 相连的LED,用于显示电池包的相对电量。
3	DVSS	显示驱动器接地,LED显示驱动器的接地端,连接至V <sub>SS</sub> 。
4	V <sub>DD</sub>	电源输入,通过去耦网络连接至电池正极。
5	OVD	1-Wire总线速率控制。输入逻辑电平选择1-Wire总线速率。逻辑1选择高速驱动(OVD)时序;逻辑0选择标准驱动 (STD)时序。在多节点总线上,所有器件必须以相同速率工作。
6	V <sub>SS</sub>	器件地,直接连接至电池负极。请将检流电阻连接在V <sub>SS</sub> 和SNS之间。
7	DQ	数据输入/输出,1-Wire数据线、漏极开路输出驱动器。将该引脚连接至电池包的DATA端。该引脚具有内部弱下拉(I <sub>PD</sub> ),可以检测电池包是否与主机或充电器断开连接。
8	VMA	电压测量有效状态指示,该引脚在电压转换启动之前被驱动至高电平;在转换周期结束时被驱动至低电平。
9	SNS	检流电阻连接。该引脚连接至电池包的负极,将检流电阻连接在V <sub>SS</sub> 和SNS之间。
10	VIN	电压检测输入。通过该输入引脚监测单节电池的电压。
11	PIO	可编程的I/O引脚。该引脚可配置为输入或输出,用于监测或控制用户定义的外部电路。输出驱动器为开漏模式。 该引脚具有内部弱下拉(Ipp)。当配置为输入时,识别到上升沿后使能电量计显示。
12	LED5	显示器驱动,连接至与V <sub>DD</sub> 相连的LED,用于显示电池包的相对电量。配置4个LED时,该引脚悬空。
13	LED4	显示器驱动,连接至与V <sub>DD</sub> 相连的LED,用于显示电池包的相对电量。
14	LED3	显示器驱动,连接至与V <sub>DD</sub> 相连的LED,用于显示电池包的相对电量。

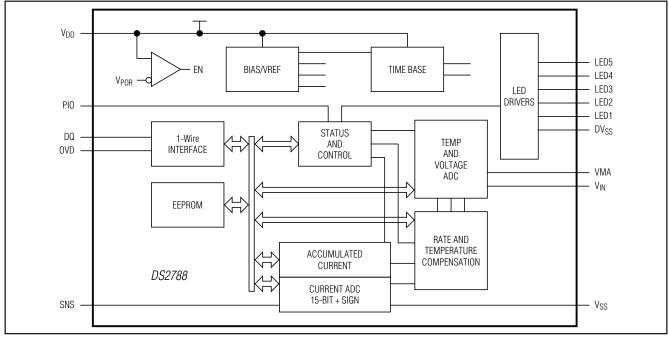


图1. 方框图

### 详细说明

### 供电模式

DS2788可以直接由2.5V至4.5V电源供电,支持单节Li+电池。 如图2所示,通过调整V<sub>IN</sub>端的外部分压电阻,DS2788也 可适应多节电池的应用。器件提供NV存储器,用于存储 电池补偿和应用参数。无需开发主机侧电量计算法,内 置算法和方便的工作状态指示可以减少主处理器的轮询 操作。

另外,16字节EEPROM存储器专供主机系统和/或电池厂 商使用。附加EEPROM存储器有助于简化电池批次与生产 日期的跟踪,并可永久保存系统或电池的使用信息。

1-Wire接口支持16kbps标准或140kbps高速串行通信速率, 用于访问数据寄存器、控制寄存器和用户存储器。器件具 有唯一的工厂预置64位注册码(8位家族码+48位序列号+ 8位CRC),确保所有器件具有唯一的序列号,从而具有绝 对可追溯性。DS2788的1-Wire接口支持多点接入,可通过 单个引脚寻址访问多个从机器件。 DS2788有两种供电模式:ACTIVE和SLEEP。上电时, DS2788的缺省模式为ACTIVE。ACTIVE模式下,DS2788 支持所有功能,可连续测量并更新电量估算结果。SLEEP 模式下,DS2788关闭测量和电量估算功能,以节省功耗, 但仍保存寄存器的内容。器件会在两种情况下进入SLEEP 模式,每种情况均具有一个使能位,可以有选择地切换 到SLEEP模式。通过设置供电模式(PMOD)位或欠压使能 位(UVEN)均可使能SLEEP模式。

PMOD位置1且DQ引脚为低电平的持续时间达到t<sub>SLEEP</sub>(标称值为2s)时,进入PMOD SLEEP模式。DQ为低电平的时间 t<sub>SLEEP</sub>可用来检测电池包断开连接或系统关断的状况,这些 状况下不会有充电或放电电流流过。DQ拉高时,DS2788 将从PMOD SLEEP模式转为ACTIVE模式。

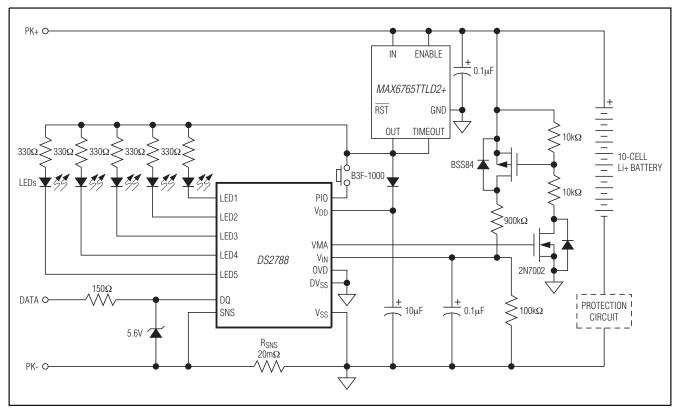


图2. 多节电池应用实例



第二种进入SLEEP模式的情况是欠压条件。当UVEN位置 1时,如果 $V_{IN}$ 电压低于 $V_{SLEEP}$ (标称值为2.45V)并且DQ保 持为高或低电平的时间达到 $t_{SLEEP}$ ,DS2788进入SLEEP模 式。欠压状态出现在电池完全放电时,此时电池的带载 能力最低。UVEN SLEEP模式可降低 $I_{ACTIVE}$ 负载电流,直 到DQ恢复通信。

注:当电池在没有DQ引脚连接的条件下由外部充电器充电时,必须禁止PMOD和UVEN SLEEP功能。如果充电器可将DQ拉高,则可启用PMOD SLEEP模式。如果充电器能够触发DQ引脚,则可启用UVEN SLEEP模式。如果充电时充电器不能正确驱动DQ,DS2788将保持在SLEEP模式,不会测量和累计电流。

### SLEEP模式下启动通信

在PMOD SLEEP模式下与DS2788通信时,必须先将DQ拉高,然后由主机发出1-Wire复位脉冲。UVEN SLEEP模式下,通信过程取决于进入UVEN SLEEP模式时的DQ状态。如果当时DQ为低,则必须先将DQ拉高,然后由主机发出1-Wire复位脉冲,与PMOD SLEEP模式类似。如果进入UVEN SLEEP模式时DQ为高,则DS2788已准备就绪接收

主机发出的1-Wire复位脉冲。在前两种SLEEP模式下DQ 为低的情况中,DS2788在DQ的第一个上升沿*不会应答*在 线脉冲。

### 电压测量

通过测量V<sub>IN</sub>输入获得电池电压,相对于V<sub>SS</sub>电压范围为0 至4.5V,分辨率为4.88mV。每440ms更新一次测量结果, 并以二进制补码形式存放在电压(VOLT)寄存器中。高于 最大寄存器数值的电压,读数为最大寄存器值;低于最 小寄存器数值的电压,读数为最小寄存器值。电压寄存 器的格式如图3所示。

 $V_{IN}$ 通常通过 $lk\Omega$ 电阻连接至单节Li+电池的正极。该引脚 的输入阻抗非常大(15M $\Omega$ ),可以在支持多节电池应用中 与高阻分压器连接在一起。电池包电压应除以串联电池 的节数,以便在 $V_{IN}$ 输入得到平均的单节电池电压。图2 中,R值可高达 $lM\Omega$ ,不会因输入负载导致较大的误差。 VMA引脚在电压转换开始之前的 $t_{PRE}$ 时间驱动至高电平, 允许外部开关元件使能电阻分压器并在转换开始之前进 入稳定状态。

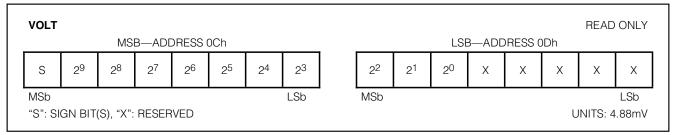


图3. 电压寄存器格式

### 温度测量

DS2788利用一个内置温度传感器测量电池温度,分辨率为0.125℃。每440ms更新一次温度测量结果,并以二进制补码形式存放在温度寄存器(TEMP)中,温度寄存器的格式如图4所示。

### 电流测量

ACTIVE模式下,DS2788通过测量低阻值检流电阻R<sub>SNS</sub>两端的压差连续监测流入和流出电池的电流。SNS和V<sub>SS</sub>之

间的电压检测范围为±51.2mV。只要连续信号电平(转换周期内的平均值)不超过±51.2mV,输入可线性地转换幅度高达102.4mV的峰值信号。ADC以18.6kHz速率对输入进行差分采样,并在每个转换周期完成时更新电流(CURRENT)寄存器。

每3.515s更新一次电流寄存器,电流转换结果以二进制补码形式保存。高于最大寄存器数值的充电电流,读数为最大寄存器值(7FFFh = +51.2mV)。低于最小寄存器数值的放电电流,读数为最小寄存器值(8000h = -51.2mV)。

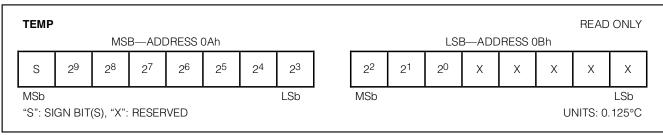


图4. 温度寄存器格式

CURF	ENT	MS	B—ADI	DRESS	OEh						LSI	3—ADE	RESS (	)Fh	READ	ONLY
S	2 <sup>14</sup>	2 <sup>13</sup>	212	211	2 <sup>10</sup>	2 <sup>9</sup>	2 <sup>8</sup>		2 <sup>7</sup>	2 <sup>6</sup>	2 <sup>5</sup>	24	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>
MSb "S": S	GN BIT	(S)				CURR	LSb	ESOLU	MSb	LSB)			U	NITS: 1	.5625µ\	LSb //R <sub>SNS</sub>
									R <sub>SNS</sub>							
			'ee - Vei	ve L					1.014	5						
		V	'ss - Vsi	NS -	20	mΩ		15mΩ		10r	mΩ		5mΩ			

图5. 电流寄存器格式

## 平均电流测量

平均电流(IAVG)寄存器的读数为前28s内的平均电流。该 寄存器为二进制补码形式,每28s更新一次,其值为之前8 个电流寄存器更新值的平均,平均电流寄存器的格式如 图6所示。高于最大寄存器数值的充电电流,读数为最大 寄存器值(7FFFh = +51.2mV)。低于最小寄存器数值的放电 电流,读数为最小寄存器值(8000h = -51.2mV)。

### 电流失调校准

进行第1024次转换时,ADC将测量其输入失调以进行失 调校准。失调校准大约每小时进行一次。所得到的校准 系数用来校准后续的1023次测量结果。在输入失调信号 转换过程中,ADC不测量检流电阻的信号。累计电流寄 存器(ACR)的最大误差可能达到1/1024;但为了减小该误 差,电流寄存器用失调转换前的电流测量结果取代电流 累计过程中漏掉的这次电流测量。这就使得由失调校准 所导致的累计电流误差小于1/1024。

电流偏移

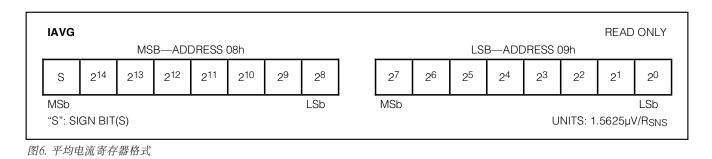
电流偏移(COB)寄存器允许给原始电流测量结果追加一个可编程的偏移量。原始电流测量结果加上COB值作为电

流测量结果存入电流寄存器,并用于电流累计。COB可 用来校准静态失调误差,或用来对电流测量结果增加一 个偏移量,并相应地对电流累计值增加偏移。

COB允许读写访问。无论何时写人COB,新数值都将追加 至后续的电流测量结果。COB能以1.56µV的步长进行编程, 范围为+198.1µV至-199.7µV。COB的值以二进制补码形式 存储在非易失性存储器中。

电流测量校准

DS2788的电流测量增益可以通过RSGAIN寄存器调整,并 在出厂前进行了校准以满足数据资料给出的精度指标。 用户可以访问RSGAIN,并可在模块或电池包制造完成后 重新设置,以提高电流测量精度。调整RSGAIN可修正 外部检流电阻标称值的误差,从而允许使用低成本的低 精度检流电阻。RSGAIN是一个11位数值,存储在参数 EEPROM存储模块的2个字节内。RSGAIN的数值可在0至 1.999范围内调整增益,步长为0.001 (确切值为2<sup>-10</sup>)。用户 必须谨慎设置RSGAIN,以确保精确的电流测量。器件出 厂时增益校准值存储在参数存储器EEPROM的两个不 同区域:可重新设置的RSGAIN和只读存储器FRSGAIN。 RSGAIN确定电流测量增益,只读FRSGAIN(地址B0h和 B1h)仅用于保存工厂设置,在电流测量中并未使用。



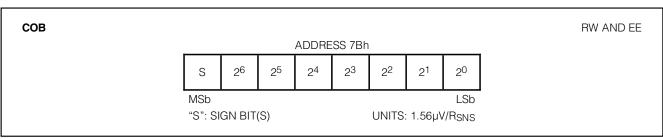


图7. 电流偏移寄存器格式

## 检流电阻温度补偿

## 电流累计

DS2788能够对检流电阻进行温度补偿,以修正检流电阻 阻值随温度的变化。DS2788的检流电阻温度系数RSTC在 出厂时设置为零,即关闭了温度补偿功能。用户可访问 RSTC,当使用具有较大温度系数的检流电阻时,可以在 模块或电池包制造完成后重新编程RSTC,以提高电流测 量精度。RSTC是一个8位数值,存储在参数EEPROM存储 器模块中。RSTC值可将温度系数设置为0至+7782ppm/°C, 步长为30.5ppm/°C。用户设置RSTC时必须慎重,以确保 精确的电流测量结果。

当温度寄存器数值跨越0.5℃边界时,将调整温度补偿值。 检流电阻应尽可能靠近V<sub>SS</sub>端,以优化该电阻与片上温度 传感器之间的热传导,得到最佳温度补偿效果。如果用 铜箔PCB走线构建电流检测通路,应尽可能使该走线位于 DS2788的封装下方。 每次转换周期结束时,电流测量值在片内求和或累计, 并将结果存储在ACR内。ACR的精度取决于电流测量和 转换时基的精度。ACR的范围为0至409.6mVh,LSb (最低 有效位)为6.25μVh。附加的只读存储器(ACRL)保存每次累 计结果的小数部分,以消除截断误差。充电电流的累计 值大于最大寄存器值时,读数为最大寄存器值(7FFFh); 相反,放电电流累计值低于最小寄存器值时,读数为最 小寄存器值(8000h)。

ACR允许进行读、写操作,写ACR时必须先写MSB (最高有效字节),再写LSB (最低有效字节)。写操作必须在3.515s (一个ACR寄存器更新周期)内完成。写ACR将强制ADC执行一次失调校准转换并更新内部失调校准系数。在写ACR后的第二次转换时开始电流测量和累计,写ACR将清除ACRL内的小数部分,ACR寄存器的格式如图8所示,ACRL寄存器的格式如图9所示。

为了在掉电时保存ACR,ACR值被备份到EEPROM。上电时从EEPROM中恢复ACR值,专用地址和备份频率请参考表3中的存储器映射。

ACR															R/W A	ND EE	
	MSB—ADDRESS 10h									LSB—ADDRESS 11h							
2 <sup>15</sup>	2 <sup>14</sup>	2 <sup>13</sup>	2 <sup>12</sup>	211	2 <sup>10</sup>	2 <sup>9</sup>	2 <sup>8</sup>		2 <sup>7</sup>	2 <sup>6</sup>	2 <sup>5</sup>	24	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	21	2 <sup>0</sup>	
MSb							LSb	-	MSb					UNITS:	6.25µVł	LSb n/R <sub>SNS</sub>	

图8. 累计电流寄存器(ACR)格式



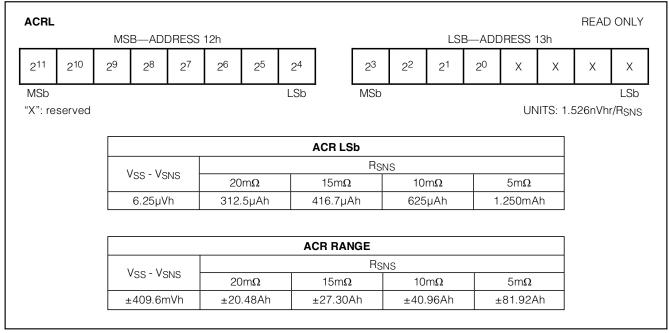


图9. 小数/小电流累计寄存器(ACRL)格式

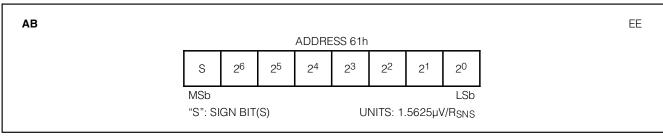


图10. 累计偏移寄存器格式

电流屏蔽

## 累计偏移

电流屏蔽功能可在电流测量结果累计到ACR之前对其进行修改。当电流测量值(原始电流值+COB)处于定义的两 个范围之一时,有条件的启用电流屏蔽功能。第一个范 围防止对检流电压低于100μV的充电电流进行累计;第二 个范围防止对检流电压低于25μV的放电电流进行累计。 充电电流屏蔽连续有效,但放电电流屏蔽功能必须通过 将控制寄存器内的NBEN位置1使能,更多信息请参考寄 存器说明。 累计偏移(AB)寄存器允许将任意偏移量引入电流累计过程,AB可用于计算流过检流电阻以外的电流、估算过小到无法测量的电流、估算电池的自放电电流或校准各DS2788器件的静态失调。AB寄存器允许在电流累计过程中引入用户设置的一个正或负恒定偏移量。用户设置的二进制补码的位权值与电流寄存器相同,在每个电流转换周期都叠加至ACR。上电时,从EEPROM存储器加载AB值,AB寄存器的格式如图10所示。

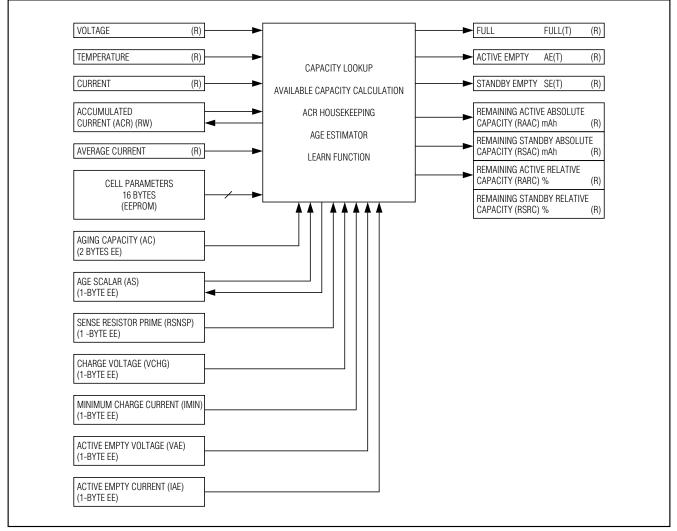


### 电量估算

估算剩余电量时,使用的数据包括实时测量值和存储器 中描述电池组特性及工作极限参数,图11说明了算法的 输入和输出。

电池组特性建模

在估算剩余电量时,为了得到合理的精度,必须考虑电 池组在不同温度、负载电流和充电终止时的性能。由于 Li+电池的非线性,在电量估算时必须考虑到这些特性才能获得满意的电量估算精度。DS2788采用的FuelPack™估算方法在应用笔记131:Lithium-Ion Cell Fuel Gauging with Maxim Battery Monitor ICs中进行了介绍。为提高硬件工作效率,DS2788对AN131给出的方法进行了改进,将电池特性参数存储在器件内。通过包括满电量、有效空电量和待机空电量三条模型曲线的分段拟合,线性建模,可重新获得满电量和空电量点。每条模型曲线由五个线段组成,标号为1至5。温度超过+50°C时,第5段模型曲线







以零斜率无限延伸,以逼近温度在+50℃以上时Li+电池电量的近似平坦变化。每条模型曲线的第4段的上部开始于+50℃,并且向下延伸至+25℃。第3段与第2段相连,第2段与第1段相连。每一条模型曲线的第1段从与第2段的交点处开始无限延伸至更低的温度。各段斜率以µVh ppm/℃的形式存储。连接各段的两个连接点或转折点(标记为TBP12和TBP23,参见图12)可编程为-128℃至+25℃,步长为1℃。它们以二进制补码形式存储,TBP23位于7Ch,TBP12位于7Dh。第1、2、3和4段的斜率或导数也可编程设置。

**满电量**: 满电量曲线定义了给定充电终止模式下某电池 组的满电量随温度变化的情况。实际应用中的充电终止 模式将决定表中的数值。DS2788根据电池特性表中的值重 建满电量曲线,以确定各温度时电池的满电量。温度每 增加1°C时进行一次重建。满电量值存储为变化率ppm/°C 的形式。例如,如果电池的标称容量为+50°C时1214mAh, 在+25°C时的满电量为1199mAh,0°C (TBP23)时为1182mAh, 则第3段的斜率为:

#### ((1199mAh - 1182mAh) / (1214mAh / 1M)) / (25°C - 0°C) = 560ppm/°C

斜率寄存器的1个LSB等于61ppm,因此整个第3段的斜率 寄存器(地址为0x6Dh)将被编程为0x09h。每个斜率寄存器 的动态范围为0ppm至15555ppm。

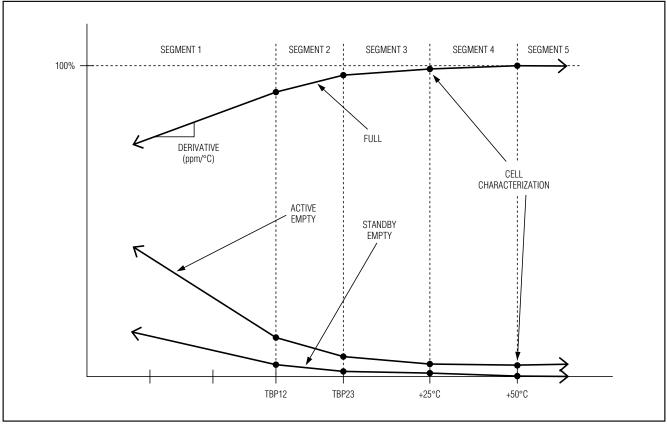


图12. 电池模型示例图

有效空电量:有效工作时的空电池电量曲线基于较大负载电流(工作在较大功率模式下的持续电流)以及系统工作所需的最小电压,定义了空电池电量点随温度的变化情况。该负载电流被编程为有效空电流(IAE),为3.5s时间内的平均值,与电流寄存器的读数相对应,而指定的最小电压或有效空电压(VAE)是250ms内的平均值,与电压寄存器的读数相对应。DS2788根据电池特性表中的值重建有效空电量曲线,以确定各温度时电池的有效空电量。温度每增加1°C时重建一次有效空电量。有效空电量各段的斜率采用与满电量段相同的方式存储。

**待机空电量**:待机空电池电量曲线定义了在具体应用中 由待机工作时所需的待机电流和最低电压所确定的空电 池电量点随温度的变化情况。待机空电量点表示电池已 不能再支持应用中某个子功能的运行,如手机的存储器 数据保持或管理功能。待机空电量各段的斜率采用与满 电量段相同的方式存储。

待机负载电流和电压用来确定电池特性,但并不能编程至DS2788中。DS2788依照电池特性表中的值重建待机空电量曲线,以确定各温度时电池的待机空电量。温度每增加1℃时重建一次待机空电量。

表1. 电池特性表范例(归一化至+50°C)

## 建立电池组模型

建立模型时所有点都归一化为+50°C时电池完全充满的状态。初始值、以mVh为单位的+50°C满电量值和占+50°C时满电量值一小部分的有效空电量值存储在电池参数 EEPROM模块中。+50°C时的待机空电量值被定义为零, 不需要储存。每种模型曲线中4段斜率(导数)与各段的转 折温度也存放在电池参数EEPROM模块中。表1给出了采 用这种方式的存储数据范例。

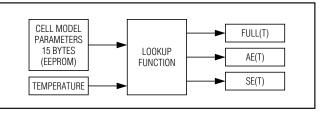


图13. 查找功能框图

Manufacturer's Rated Cell Capacity: 1220mAh							
Charge Voltage: 4.2V Charge Current: 500mA		Termination Current: 50mA					
Active Empty (V, I): 3.0V, 500mA		Standby Empty (V, I): 3.0V, 4mA					
Sense Resistor: 0.020 $\Omega$							

#### SEGMENT BREAKPOINTS

TBP12 = -12°C TBP23 = 0°C

CALCULATED VALUE	+50°C NOMINAL (mAh)	SEGMENT 1 (ppm/°C)	SEGMENT 2 (ppm/°C)	SEGMENT 3 (ppm/°C)	SEGMENT 4 (ppm/°C)
Full	1214	488	549	1587	2686
Active Empty		854	1526	2686	3113
Standby Empty		244	183	916	244

### 应用参数

除了电池模型特性参数以外,还需要几个应用参数来检 测电池满电量点和空电量点,以及计算mAh为单位的 结果。

#### 检流电阻初值(RSNSP)

RSNSP存储检流电阻的值,用来计算绝对电量。该数值以 1字节电导的形式保存,单位为西门子。RSNSP支持1Ω至 3.922mΩ的电阻值。RSNSP位于参数EEPROM模块中。

#### 充电电压(VCHG)

VCHG存储充电电压门限值,用来检测完全充满状态。该数值以1个字节电压的形式保存,单位为19.52mV,范围为0至4.978V。VCHG的设定值应稍小于充电周期结束时的单节电池电压,以确保可靠的充电终止检测。VCHG位于参数EEPROM模块中。

#### 最小充电电流(IMIN)

IMIN存放充电电流门限,用来检测完全充满状态。该数 值以1个字节电压形式保存,单位为 $50\mu$ V,范围为0至 12.75mV。假设R<sub>SNS</sub> = 20m $\Omega$ ,则IMIN可在0至637.5mA之 间设置,步长为2.5mA。IMIN的设定值应当稍大于充电周 期结束时的充电电流,以确保可靠的充电终止检测。 IMIN位于参数EEPROM模块中。

#### 有效空电压(VAE)

VAE存储用于检测有效工作时空电池电量点的电压门限。 该值存储在1个字节的空间内,单位为19.52mV,范围为0 至4.978V。VAE位于参数EEPROM模块中。

### 有效空电流(IAE)

IAE存储用于检测有效工作时空电池电量点的放电电流门限。这个无符号数表示放电电流的大小,以电压形式存储在1个字节的空间内,单位为200 $\mu$ V,范围从0至51.2mV。假设R<sub>SNS</sub> = 20m $\Omega$ , IAE能以10mA步长编程为0mA至2550mA。IAE位于参数EEPROM模块中。

#### 老化容量(AC)

AC存放额定电池电量,用来估算正常使用情况下电池容量减少的情况。该数值存放在2个字节的空间内,单位与

ACR相同(6.25µVh)。AC设置为制造商给出的额定电量时, 老化速率设置为每100个等效完全放电周期约2.4%。对于 部分放电周期,则相加以折合成等效完全放电周期。在 500个等效周期后,缺省估算结果为88%。通过将AC设置 为与厂商额定值不相同的值,能够调节老化估计速率。 将AC设置为较小值,可加大老化估计速率。将AC设置为 较大值时,则减缓老化估计速率。AC位于参数EEPROM 模块中。

#### 老化系数(AS)

AS可以逐步调低电池容量估计结果,以补偿电池老化特性。AS值的长度为1个字节,范围为49.2%和100%。最低LSB的权值为0.78% (确切值为2<sup>-7</sup>)。AS值为100% (十进制128或80h)时表示电池未老化。制造电池包时,推荐将AS初始值设为95%,以允许在电池初始容量大于电池特性表中编程的标称容量时学习该较大的容量值。通过上述基于放电次数的老化估计和容量学习功能编程AS值。主机系统可以读写访问AS,但在写AS时必须慎重,以免累积后的老化估计值被错误数值覆盖。通常,不需要通过主机写AS,因为DS2788会将AS自动定期保存到EEPROM内(详见存储器部份)。上电时重新恢复EEPROM存储的AS值。

### 电量估算功能

#### 老化估计

如前文所述,根据累计放电次数会不定期调整AS寄存器的值。当每次放电周期内ACR寄存器递减时,一个内部计数器会递增,直至等于32倍的AC。然后AS值减1,电池满容量减少0.78%。关于定制老化估计速率的推荐值,请参考上文的AC寄存器说明。

#### 学习功能

由于Li+电池的充电效率接近1,从已知空电量点充电到已 知满电量点时充入Li+电池的电荷量是测量电池电量的可 靠依据。从空电量连续充电到满电量实现一个"学习周期"。 首先,必须检测到有效空电量点。学习标志(LEARNF)将 在这一点置位。然后,一旦开始充电,必须不间断地持 续充电,直到电池充满。当检测到电池充满时,将清除 LEARNF标志,置位充满(CHGTF)标志,并按照学习到的 电池容量调整老化系数(AS)。

#### ACR管理

有时需要调整ACR寄存器值,使库仑计数处于模型曲线范围内。当电池充满(CHGTF置1)时,对当前温度下的满电量查找值进行老化修正,并以该修正结果设置ACR。如果正在执行学习周期,则在更新老化系数(AS)之后再校正ACR值。

当检测到空电量状态(AEF或LEARNF置1)时,有条件的调整ACR。如果AEF置1而LEARNF未置1,则未检测到有效空电量点,电池电量有可能低于模型的有效空电量。只有当ACR大于有效空电量模型值时,才能将ACR设置为有效空电量模型值。如果LEARNF置1,则电池处于有效空电量点,并且ACR设置为有效空电量模型值。

#### 满电量检测

如果电压(VOLT)读数在两次平均电流(IAVG)读数之间始 终高于VCHG门限,并且两个IAVG读数都低于IMIN,则 检测到满电量。这两个连续的IAVG读数还必须是非零的 正数。这样才能确保从充电器中取出电池时不会导致错 误的满电量检测。检测到满电量时将状态(STATUS)寄存 器中的充满(CHGTF)位置1。

#### 有效空电量检测

当电压寄存器数值跌至VAE门限以下,并且先前的两个 电流读数大于IAE时,则检测到有效空电量点。据此捕捉 到了电池达到有效空电量的事件。需要注意的是,先前 的两个电流读数必须为负,并且幅度要大于IAE,也就是 说,大于IAE门限规定值的放电电流。同时测量电压值和 放电速率可确保不会在负载电流低于构建模型所用值时 检测到有效空电量。同样,如果先使用非常轻的负载深 度放电,紧接着使用大于IAE的负载时,也不会检测到有 效空电量。否则,在接下来的电池充满学习周期中,两 种情况都会导致有效容量测量结果中包含部分待机容量。 检测到有效空电量时将置位STATUS寄存器中的学习标志 位(LEARNF)。

### 结果寄存器

DS2788以3.5s的间隔时间处理测量结果和电池特性参数, 并产生7个结果寄存器值。在大多数应用中,结果寄存器 直接用于用户显示已经足够。结合测量数据、结果和用 户EEPROM值,主机系统可生成系统所用的定制数据或用 户显示数据。

**FULL(T)**:报告当前温度下电池的满电量,归一化为+50°C时满电量的百分比。这个15位数值反映了给定温度下电池组模型的满电量值。FULL(T)值在100%和50%之间,分辨率为61ppm(确切值为2<sup>-14</sup>)。虽然寄存器格式允许数值大于100%,但寄存器值被箝位在100%的最大值。

**有效空电量**, **AE(T)**:报告当前温度下电池的有效空电量, 归一化为+50°C时满电量的百分比。这个13位数值反映了 给定温度下电池组模型的有效空电量。AE(T)值在0%和 49.8%之间,分辨率为61ppm (确切值为2<sup>-14</sup>)。

**待机空电量**, **SE(T)**:报告当前温度下电池的待机空电量, 归一化为+50°C时满电量的百分比。这个13位数值反映了 当前温度下电池组模型的待机空电量。SE(T)值在0%和 49.8%之间,分辨率为61ppm (确切值为2<sup>-14</sup>)。

**剩余绝对有效电量RAAC**, **[mAh]**: RAAC报告当前温度下 从有效工作状态下的空放电量(IAE)到有效空电量时能够 得到的电量,以绝对值表示,单位为mAh。RAAC为16位。 请参见图14。

**剩余绝对待机电量RSAC**, **[mAh]**: RSAC报告当前温度 下从待机状态下的空放电量(ISE)到待机空电量时能够得 到的电量,以绝对值表示,单位为mAh。RSAC为16位。 请参见图15。

**剩余相对有效电量RARC**, [%]: RARC报告当前温度下 从有效工作状态下的空放电量(IAE)到有效空电量时能够 得到的电量,以相对百分比表示,RARC为8位。请参见 图16。

**剩余相对待机电量RSRC**, [%]: RSRC报告当前温度下从 待机状态下的空放电量(ISE)到待机空电量时能够得到的 电量,以相对百分比表示, RSRC为8位。请参见图17。



RAAC MSB—ADDRESS 02h											LSI	B—AD[	DRESS	03h	READ	ONLY
2 <sup>15</sup>	2 <sup>14</sup>	2 <sup>13</sup>	2 <sup>12</sup>	2 <sup>11</sup>	2 <sup>10</sup>	2 <sup>9</sup>	2 <sup>8</sup>		27	26	2 <sup>5</sup>	24	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	21	20
MSb				-			LSb		MSb				-	U	NITS: 1.	LSb 6mAhr

图14. 剩余绝对有效电量寄存器格式

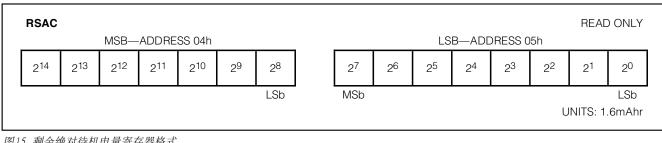


图15. 剩余绝对待机电量寄存器格式

RARC				ADDRE	:SS 06h				READ ONI	LY
	2 <sup>7</sup>	26	2 <sup>5</sup>	24	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>		
	MSb						UNI	LSb FS: 1%		

图16. 剩余相对有效电量寄存器格式

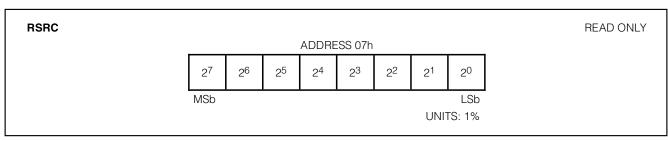


图17. 剩余相对待机电量寄存器格式

计算结果

RAAC [mAh] = (ACR[mVh] - AE(T) × FULL50[mVh]) × RSNSP [mhos]
RSAC [mAh] = (ACR[mVh] - SE(T) × FULL50[mVh]) × RSNSP [mhos]
RARC [%] = 100% × (ACR[mVh] - AE(T) × FULL50[mVh]) / {(AS × FULL(T) - AE(T)) × FULL50[mVh]}
RSRC [%] = 100% × (ACR[mVh] - SE(T) × FULL50[mVh]) / {(AS × FULL(T) - SE(T)) × FULL50[mVh]}

状态寄存器

状态寄存器包含器件状态指示位,这些位均可由DS2788 内部置位,其中CHGTF、AEF、SEF和LEARNF位为只读 位,由硬件清除。而UVF和PORF只能通过1-Wire接口清零。

ADDIILOO	ESS 01h		BIT DEFINITION				
Field	Bit	Format	Allowable Values				
CHGTF	7	Read Only	Charge Termination Flag Set to 1 when: (VOLT > VCHG) and (0 < IAVG < IMIN) continuously for a perio between two IAVG register updates (28s to 56s). Cleared to 0 when: RARC < 90%				
AEF	6	Read Only	Active Empty Flag Set to 1 when: VOLT < VAE Cleared to 0 when: RARC > 5%				
SEF	5	Read Only	Standby Empty Flag Set to 1 when: RSRC < 10% Cleared to 0 when: RSRC > 15%				
LEARNF	4	Read Only	Learn Flag—When set to 1, a charge cycle can be used to learn battery capacity. Set to 1 when: (VOLT falls from above VAE to below VAE) and (CURRENT > IAE) Cleared to 0 when: (CHGTF = 1) or (CURRENT < 0) or (ACR = $0^{**}$ ) or (AC written or recalled from EEPROM) or (SLEEP Entered).				
Reserved	3	Read Only	Undefined				
UVF	2	Read/Write*	Undervoltage Flag Set to 1 when: VOLT < V <sub>SLEEP</sub> Cleared to 0 by: User				
PORF	1	Read/Write*	Power-On Reset Flag—Useful for reset detection, see text below. Set to 1 when: upon power-up by hardware. Cleared to 0 by: User				
	0	Read Only	Undefined				

图18. 状态寄存器格式

## 控制寄存器

所有控制寄存器位都可进行读、写操作。上电时,控制 寄存器从参数EEPROM存储器中读出数据。上电后,可在 映射RAM中修改寄存器位的数值。利用Copy Data命令,可将映射RAM内的数值保存为上电缺省值。

ADDRESS		60h	BIT DEFINITION
Field Bit Format		Format	Allowable Values
NBEN	7	Read/Write	Negative Blanking Enable 0: Allows negative current readings to always be accumulated. 1: Enables blanking of negative current readings up to -25µV.
UVEN	6	Read/Write	Undervoltage SLEEP Enable 0: Disables transition to SLEEP mode based on V <sub>IN</sub> voltage. 1: Enables transition to SLEEP mode if V <sub>IN</sub> < V <sub>SLEEP</sub> and DQ are stable at either logic level for t <sub>SLEEP</sub> .
PMOD	5	Read/Write	Power Mode Enable 0: Disables transition to SLEEP mode based on DQ logic state. 1: Enables transition to SLEEP mode if DQ is at a logic-low for t <sub>SLEEP</sub> .
RNAOP	4	Read/Write	Read Net Address Op Code 0: Read net address command = 33h. 1: Read net address command = 39h.
DC	3	Read/Write	Display Control 0: Enables LED5 fuel-gauge display. 1: Enables LED4 fuel-gauge display.
Reserved	0:2		Undefined

图19. 控制寄存器格式



特殊功能寄存器

特殊功能寄存器的所有位都可进行读、写操作,在每一 位的定义中给出了其缺省值。

ADDRESS		15h	BIT DEFINITION		
Field	Bit	Format	Allowable Values		
Reserved	1:7		Undefined		
PIOSC	0	Read/Write	<ul> <li>PIO Sense and Control Read values:</li> <li>0: PIO pin ≤ V<sub>IL</sub></li> <li>1: PIO pin ≥ V<sub>IH</sub></li> <li>Write values:</li> <li>0: Activates PIO pin open-drain output driver, forcing the PIO pin low.</li> <li>1: Disables the output driver, allowing the PIO pin to be pulled high or used as an input.</li> <li>Power-up and SLEEP mode default: 1 (PIO pin is high-Z).</li> <li>Note: PIO pin has weak pulldown.</li> </ul>		

图20. 特殊功能寄存器格式

表2.	电量显示器
-----	-------

表2总结了LED的使能情况,B表示LED以0.5s点亮、0.5s 熄灭的50%占空比闪烁,重复显示时间为4s。L表示该引 脚拉低,点亮LED。X表示该引脚为高阻态,没有点亮 LED。

CAPACITY	5 LEDs, DC: 0 LED5–LED1	4 LEDs, DC: 1 LED4–LED1						
$RARC \le 10$	XXXXB	XXXB						
$10 < RARC \le 20$	XXXXL	XXXL						
$20 < RARC \le 25$	XXXLL	XXXL						
$25 < RARC \le 40$	XXXLL	XXLL						
$40 < RARC \le 50$	XXLLL	XXLL						
$50 < RARC \le 60$	XXLLL	XLLL						
$60 < RARC \le 75$	XLLLL	XLLL						
75 < RARC ≤ 80	XLLLL	LLLL						
80 < RARC ≤ 100	LLLLL	LLLL						

## EEPROM寄存器

EEPROM寄存器提供对EEPROM模块的访问控制。可以锁存EEPROM模块以防止更改模块中的数据。模块锁存后将

禁止对其进行写操作。一旦模块锁存将无法解锁。对 EEPROM模块的读操作不受锁定/解锁状态的影响。

ADDRESS		1Fh	BIT DEFINITION
Field	Bit	Format	Allowable Values
EEC	7	Read Only	EEPROM Copy Flag Set to 1 when: Copy Data command executed. Cleared to 0 when: Copy Data command completes. Note: While EEC = 1, writes to EEPROM addresses are ignored. Power-up default: 0
LOCK	6	Read/Write to 1	EEPROM Lock Enable Host write to 1: Enables the Lock command. Host must issue Lock command as next command after writing lock enable bit to 1. Cleared to 0 when: Lock command completes or when Lock command is not the command issued immediately following the Write command used to set the lock enable bit. Power-up default: 0
Reserved	2:6		Undefined
BL1	1	Read Only	EEPROM Block 1 Lock Flag (Parameter EEPROM 60h-7Fh) 0: EEPROM is not locked. 1: EEPROM block is locked. Factory default: 0
BLO	0	Read Only	EEPROM Block 0 Lock Flag (User EEPROM 20h–2Fh) 0: EEPROM is not locked. 1: EEPROM block is locked. Factory default: 0

图21. EEPROM寄存器格式

### 存储器

DS2788具有256字节线性存储器空间,包括测量寄存器、 状态和控制寄存器,以及用于存储参数和用户信息的 EEPROM存储器。读取标注为"Reserved"的字节地址时将 返回未定义的数据。不能对保留字节进行写操作。为了 存储16位数值,一些字节寄存器成对组成双字节寄存器, 16位数值的MSB位于偶数地址,而LSB位于下一个地址 (奇数)字节。读取双字节寄存器的MSB时,MSB和LSB被 同时锁存,并在读数据命令期间保持不变,以防止在读 期间更新LSB。这样保证了两个寄存器字节之间的同步。 为获得有效的结果,一定要在同一个Read Data命令期间 读取双字节寄存器的MSB和LSB。

EEPROM存储器包含非易失性EEPROM单元,并具有相应的易失映射RAM。Read Data和Write Data命令允许1-Wire 接口直接访问映射RAM。Copy Data和Recall Data功能命令可在映射RAM和EEPROM单元之间传输数据。为了修改存储在EEPROM单元中的数据,必须先将数据写入映射RAM,然后复制到EEPROM中。为了校验存储在EEPROM单元中的数据,必须将EEPROM数据调入映射RAM,再从映射RAM中读取数据。

#### 用户EEPROM

16字节用户EEPROM存储器(模块0,地址20h-2Fh)提供与 其它DS2788功能无关的非易失存储器。访问用户EEPROM 模块不会影响DS2788的工作。用户EEPROM可锁存,锁 存时将禁止写操作。电池包或主机系统制造商可编程批 次代码、日期码以及其它制造、质保或诊断信息,然后 锁定以保护数据。用户EEPROM还可存储充电参数以支持 主机设备中不同尺寸的电池,以及辅助的模型数据,如 完全充满的时间估计参数。

#### 参数EEPROM

电池模型数据以及应用参数都存储在参数EEPROM存储器 中(模块1,地址60h-7Fh)。当RARC结果越过4%的边界值时, ACR (MSB和LSB)和AS寄存器将被自动保存到EEPROM 中。这可使DS2788位于保护FET之外。采用这种方式, 如果触发了保护器件,DS2788不会丢失超过4%的充电或 放电数据。

### 表3. 存储器映射

ADDRESS (HEX)	DESCRIPTION	READ/WRITE
00	Reserved	R
01	STATUS: Status Register	R/W
02	RAAC: Remaining Active Absolute Capacity MSB	R
03	RAAC: Remaining Active Absolute Capacity LSB	R
04	RSAC: Remaining Standby Absolute Capacity MSB	R
05	RSAC: Remaining Standby Absolute Capacity LSB	R
06	RARC: Remaining Active Relative Capacity	R
07	RSRC: Remaining Standby Relative Capacity	R
08	IAVG: Average Current Register MSB	R
09	IAVG: Average Current Register LSB	R
0A	TEMP: Temperature Register MSB	R
OB	TEMP: Temperature Register LSB	R
OC	VOLT: Voltage Register MSB	R
0D	VOLT: Voltage Register LSB	R
OE	CURRENT: Current Register MSB	R
0F	CURRENT: Current Register LSB	R
10	ACR: Accumulated Current Register MSB	R/W*
11	ACR: Accumulated Current Register LSB	R/W*

## 表3. 存储器映射(续)

ADDRESS (HEX)	DESCRIPTION	READ/WRITE
12	ACRL: Low Accumulated Current Register MSB	R
13	ACRL: Low Accumulated Current Register LSB	R
14	AS: Age Scalar	R/W*
15	SFR: Special Feature Register	R/W
16	FULL: Full Capacity MSB	R
17	FULL: Full Capacity LSB	R
18	AE: Active Empty MSB	R
19	AE: Active Empty LSB	R
1A	SE: Standby Empty MSB	R
1B	SE: Standby Empty LSB	R
1C to 1E	Reserved	_
1F	EEPROM: EEPROM Register	R/W
20 to 2F	User EEPROM, Lockable, Block 0	R/W
30 to 5F	Reserved	_
60 to 7F	Parameter EEPROM, Lockable, Block 1	R/W
80 to AD	Reserved	—
AE	FVGAIN: Factory Voltage Gain MSB	R
AF	FVGAIN: Factory Voltage Gain LSB	R
B0	FRSGAIN: Factory Sense Resistor Gain MSB	R
B1	FRSGAIN: Factory Sense Resistor Gain LSB	R
B2 to FF	Reserved	_

\*在ACTIVE模式下,寄存器值自动保存到EEPROM中,并在上电时从EEPROM中恢复数据。

## 表4. 参数EEPROM存储器模块1

ADDRESS (HEX)	DESCRIPTION	ADDRESS (HEX)	DESCRIPTION
60	CONTROL: Control Register	70	AE Segment 4 Slope
61	AB: Accumulation Bias	71	AE Segment 3 Slope
62	AC: Aging Capacity MSB	72	AE Segment 2 Slope
63	AC: Aging Capacity LSB	73	AE Segment 1 Slope
64	VCHG: Charge Voltage	74	SE Segment 4 Slope
65	IMIN: Minimum Charge Current	75	SE Segment 3 Slope
66	VAE: Active Empty Voltage	76	SE Segment 2 Slope
67	IAE: Active Empty Current	77	SE Segment 1 Slope
68	Active Empty 50	78	RSGAIN: Sense Resistor Gain MSB
69	RSNSP: Sense Resistor Prime	79	RSGAIN: Sense Resistor Gain LSB
6A	Full 50 MSB	7A	RSTC: Sense Resistor Temp Coefficient
6B	Full 50 LSB	7B	COB: Current Offset Bias
6C	Full Segment 4 Slope	7C	TBP23
6D	Full Segment 3 Slope	7D	TBP12
6E	Full Segment 2 Slope	7E	VGAIN: Voltage Gain MSB
6F	Full Segment 1 Slope	7F	VGAIN: Voltage Gain LSB

### 1-Wire总线系统

1-Wire总线是一个具有单总线主机和一个或多个从机的系统。多点总线是挂接了多个从机的1-Wire总线。而单点总线上仅有一个从机。在任何情况下,DS2788都作为从机。 主机系统中的总线主机通常是一个微处理器。对该总线 系统的讨论分为4个部分:64位网络地址、硬件配置、处 理流程以及1-Wire信令。

#### 64位网络地址

每个DS2788都带有唯一的、由工厂设置的64位1-Wire网络地址。前8位是1-Wire家族码(DS2788的家族码为32h)。 紧随其后是48位唯一的序列码。最后8位是前56位的循环 冗余校验码(CRC)(参见图22)。64位网络地址和器件内置 的1-Wire I/O电路使DS2788能够通过1-Wire协议与主机通 信,1-Wire协议的详细说明参见1-Wire总线系统部分。

#### 生成CRC

DS2788带有8位CRC校验码,存储在1-Wire网络地址的最高字节中。为了确保地址的无差错传输,主机系统可根据网络地址的前56位计算出CRC校验码,并与来自DS2788的CRC进行比较。系统主机负责校验CRC值并根据校验结

果采取相应措施。DS2788并不比较CRC校验码,当CRC校验码不匹配时,也不会阻止命令继续执行。正确利用CRC可使通信信道具有极高的完整性。

主机可利用图23所示的电路生成CRC,该电路由移位寄存器和异或门组成,也可由软件生成CRC。更多有关 Maxim 1-Wire CRC的信息请参考应用笔记27:理解和运用 Maxim <u>iButton产品中的循环冗余校验(CRC)</u>。

在图23所示的电路中,首先将移位寄存器的各位初始化为0。然后从家族码的最低有效位开始逐位移入。移入家族码的第8位后,开始移入序列码。序列码的第48位移入后,移位寄存器中的值就是CRC码。

#### 硬件配置

由于1-Wire总线系统中仅有一条数据线,因此在合适的时间驱动总线上的各个器件十分重要。为使上述操作易于 实现,挂接在1-Wire总线上的每个器件必须都通过漏极开 路或三态输出驱动器连接总线。DS2788采用开漏极输出 驱动器作为双向接口电路,如图24所示。如果总线主机 没有可利用的双向引脚,可将独立的输入、输出引脚连 接起来用。



图22. 1-Wire网络地址格式

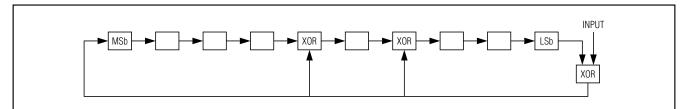


图23. 1-Wire CRC生成方框图



1-Wire总线要求在总线主机侧连接一个上拉电阻。对于较 短的数据线长度,该电阻值约为5kΩ。1-Wire总线的空闲 状态为高电平。如果由于某种原因需要暂停通信,总线 必须保持在空闲状态以便稍后恢复通信。如果总线保持 低电平的时间超过120μs (在高速模式下为16μs),则总线 上的从机设备会将该低电平周期理解为一个复位脉冲, 从而终止通信过程。

DS2788具有两种通信速率模式,即标准速率模式和高速 模式。速率模式是由OVD引脚的输入逻辑电平确定的, 逻辑0选择标准速率模式,逻辑1选择高速模式。在以复 位脉冲开始的初始化过程之前,OVD引脚必须保持稳定 的逻辑0或1。多点总线上所有1-Wire器件必须采用相同的 通信速率,以实现正常工作。标准速率模式和高速模式 的1-Wire时序在*Electrical Characteristics: 1-Wire Interface*中 列出。

通过1-Wire端口访问DS2788的协议如下:

- 初始化
- 网络地址命令

- 功能命令
- 传输/数据

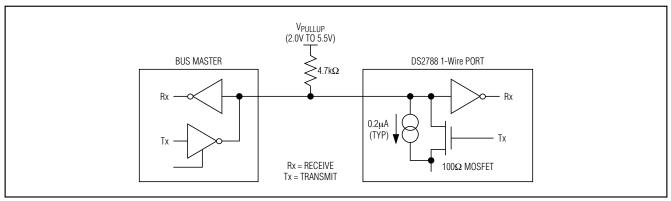
以下各节将对这几点详细讨论。

1-Wire总线的所有传输操作都从初始化过程开始,由总线 主机发送的复位脉冲以及DS2788和总线上其它从机同时 发出的在线应答脉冲组成。在线应答脉冲报告总线主机 总线上的一个或多个从设备已准备就绪。更多详细信息 请参考1-Wire信令一节。

#### 网络地址命令

一旦总线主机检测到一个或多个从设备的应答脉冲,主机 可发送下列段落所描述的网络地址命令之一。每个ROM命 令的名称后面是该命令的8位操作码(在方括号中)。图25 给出了网络地址命令流程图。

Read Net Address [33h或39h]: 该命令允许总线主机读取DS2788的1-Wire网络地址。只有当总线上挂接单个从设备时才能使用这条命令。如果总线上挂接了多个从机设备,当所有从机试图同时发送数据时(漏极开路产生"线与"结果),就会发生数据冲突。状态寄存器的RNAOP位选择该命令的操作码,RNAOP=0表示操作码为33h,RNAOP=1 表示操作码为39h。



处理流程

图24. 1-Wire总线接口电路

Match Net Address [55h]: 该命令允许总线主机访问1-Wire总线上某个特定的DS2788。只有地址匹配的DS2788 才会响应随后的功能命令。所有其它从机设备忽略随后 的功能命令并等待复位脉冲。该命令适用于总线上挂接 一个或多个从机的情况。

Skip Net Address [CCh]: 总线上仅有一个DS2788时, 该命令允许总线主机在不指定从设备地址的情况下发送 功能命令,从而可节省时间。如果总线上挂接了多个从 机,随后发出功能命令后,所有从机同时发送数据时就 会产生数据冲突。

Search Net Address [F0h]: 该命令允许总线主机采用排除法来识别总线上所有从机的1-Wire网络地址。该搜索过程重复三个简单的步骤: 读一位、读该位的补码、然后写人期望的位值。总线主机对网络地址的每个位执行这三个简单的步骤。通过所有64位操作后,总线主机就得到一个从机地址。然后,可通过反复执行该过程识别剩余从机的地址。有关网络地址搜索的全面讨论,请参阅 Book of <u>i</u>Button Standards的第5章,其中还包括一个示例 (该资料可从<u>china.maxim-ic.com/ibuttonbook</u>下载)。

Resume [A5h]: 在多点应用环境中,当需要多次访问 DS2788时,该命令提高了数据的吞吐能力。Resume命令 与Skip Net Address命令类似,即不必每次访问DS2788时都 发送64位网络地址。在成功执行Match Net Address命令或 Search Net Address命令后,DS2788内的一个标志会置位。 当该标志置1后,便可通过Resume命令重复访问DS2788。 访问总线上的其它从机时将会清除该标志,从而避免了 两个或多个从机同时响应Resume命令。 在成功地执行一个网络地址命令之后,总线主机可以通 过下列各段落所描述的任何功能命令来访问DS2788。每 个功能命令的名称后面跟着该命令的8位操作码(在方括号 中)。表5概括了所有功能命令。

Read Data [69h, XX]: 该命令从存储器地址XX开始读取 DS2788的数据。移入地址XX的最高位后,可立即读取地 址XX中数据的最低位。因为接收到每个数据字节的最高 位后,地址自动递增,因此收到地址XX中数据的最高位 后,可立即读取地址XX + 1中数据的最低位。如果总线 主机持续读取操作直至超出地址FFh,则从存储器地址00 开始读取数据,并且地址自动递增,直到产生一个复位 脉冲为止。存储器分配表中标有"Reserved"的地址包含不 确定的值。在位流的任何位置,均可由总线主机发出复 位脉冲来终止Read Data命令。读取EEPROM模块地址的 数据时将返回映射RAM中的数据。需要Recall Data命令将 数据从EEPROM传输到映射RAM。更多详细信息参见存 储器部分。

Write Data [6Ch, XX]: 该命令从存储器地址XX开始将 数据写人DS2788。移入地址的最高位后,可立即写入要 存储在地址XX处的数据最低位。因为写入每个数据字节 的最高位后地址自动递增,因此写入要存储到地址XX处 的数据最高位后,可立即写入要存储在地址XX+1处的 数据最低位。如果总线主机持续写操作直到地址超出FFh, 则从存储器地址00开始,原有数据将被覆盖。将忽略对 只读地址、保留地址和锁定EEPROM模块的写操作。不会 写入不完整的字节。写访问未锁定的EEPROM模块地址将 修改映射RAM。需要Copy Data命令将数据从映射RAM传 输到EEPROM中。更多详细信息参见*存储器*部分。

功能命令

Maxim Integrated

Copy Data [48h, XX]: 该命令将EEPROM映射RAM的内 容复制到EEPROM模块中地址为XX的EEPROM单元。寻址 锁定模块的复制数据命令将被忽略。执行复制数据命令时, EEPROM寄存器的EEC位置1,并忽略其它写EEPROM地 址的命令。在复制过程中,对非EEPROM地址的读、写操 作仍可进行。执行复制数据命令所需的时间为t<sub>EEC</sub>,从发 送完地址后的下一个下降沿开始执行。

Recall Data [B8h, XX]: 该命令可将EEPROM模块中地址 为XX的EEPROM单元存储内容恢复到EEPROM映射存储 器中。 Lock [6Ah, XX]: 该命令锁定(写保护)包含存储器地址XX 的EEPROM存储器模块。在执行锁定命令之前,必须先将 EEPROM寄存器的lock位置为1。为了避免无意识地锁定, 将lock位(EEPROM寄存器的第6位,地址为1Fh)置1后,必 须立即发送锁定命令才执行锁定操作。如果在锁定命令 之前lock位为0,或锁定位置为1后没有马上发送锁定命令, 则锁定命令不起作用。锁定命令生效后则模块永远锁定, 锁定模块再也不能重新写入。

COMMAND	DESCRIPTION	COMMAND PROTOCOL	BUS STATE AFTER COMMAND PROTOCOL	BUS DATA
Read Data	Reads data from memory starting at address XX.	69h, XX	Master Rx	Up to 256 bytes of data
Write Data	Writes data to memory starting at address XX.	6Ch, XX	Master Tx	Up to 256 bytes of data
Copy Data	Copies shadow RAM data to EEPROM block containing address XX.	48h, XX	Master Reset	None
Recall Data	Recalls EEPROM block containing address XX to RAM.	B8h, XX	Master Reset	None
Lock	Permanently locks the block of EEPROM containing address XX.	6Ah, XX	Master Reset	None

### 表5. 功能命令

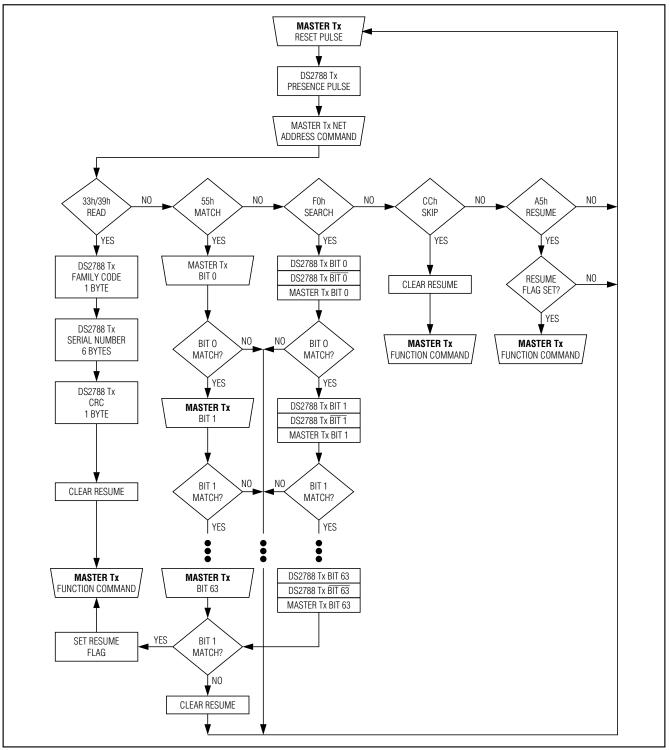


图25. 网络地址命令流程图

### 1-Wire信令

写时隙

1-Wire总线需要严格的信令协议来保证数据的完整性。 DS2788使用以下四种信令协议:初始化过程(复位脉冲和 随后的在线应答脉冲)、写0、写1以及读数据。除了在线 应答脉冲以外,所有其他信令均由总线主机发出。

与DS2788的任何通信都必须从初始化过程开始,如图26 所示。复位脉冲之后的在线应答脉冲表明DS2788已经准 备好接收网络地址命令。总线主机发出(Tx)持续t<sub>RSTL</sub>时间 的复位脉冲。然后总线主机释放数据线,进入接收模式 (Rx)。然后由上拉电阻将1-Wire总线拉至高电平。DS2788 检测到DQ引脚的上升沿后,将等待t<sub>PDH</sub>时间,然后发出 持续时间为t<sub>PDL</sub>的在线应答脉冲。

当总线主机将1-Wire总线从逻辑高(无效)电平拉至逻辑低 电平时,开始写时隙。写时隙有两种类型:写1和写0。 所有写时隙必须保持t<sub>SLOT</sub>的时间,并且两个写时隙之间 需要1µs的最小恢复时间(t<sub>REC</sub>)。DS2788将在线路下降沿之 后的15µs至60µs之间(高速模式下在2µs至6µs之间)采样 1-Wire总线数据。如果采样时总线为高电平,则为写1时隙。 如果采样时总线为低电平,则为写0时隙(参见图27)。总 线主机若要产生写1时隙,必须先拉低总线,然后释放, 在写时隙开始后的15µs(高速模式下为2µs)之内将总线拉 至高电平。主机若要产生写0时隙,必须拉低总线,并在 写时隙持续时间内保持为低电平。

#### 读时隙

当总线主机将1-Wire总线从逻辑高电平拉至逻辑低电平时,开始读时隙。总线主机必须使总线为低电平的时间至少持续1µs,然后再释放总线,使DS2788输出有效数据。总线主机在读时隙开始后的t<sub>RDV</sub>时间内采样数据。DS2788在读时隙结束时释放总线,允许外部上拉电阻将其拉至高电平。所有读时隙必须持续t<sub>SLOT</sub>,并且在两次读时隙之间需要1µs的最小恢复时间(t<sub>REC</sub>)。详细信息参见图27。

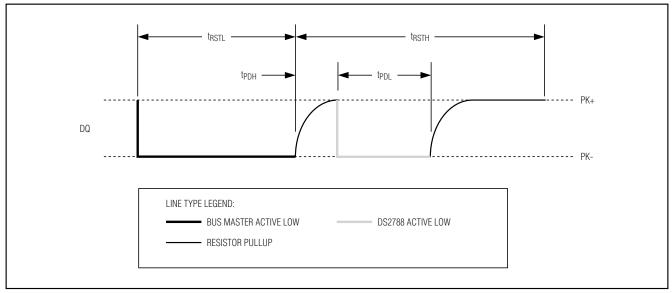


图26. 1-Wire初始化时序

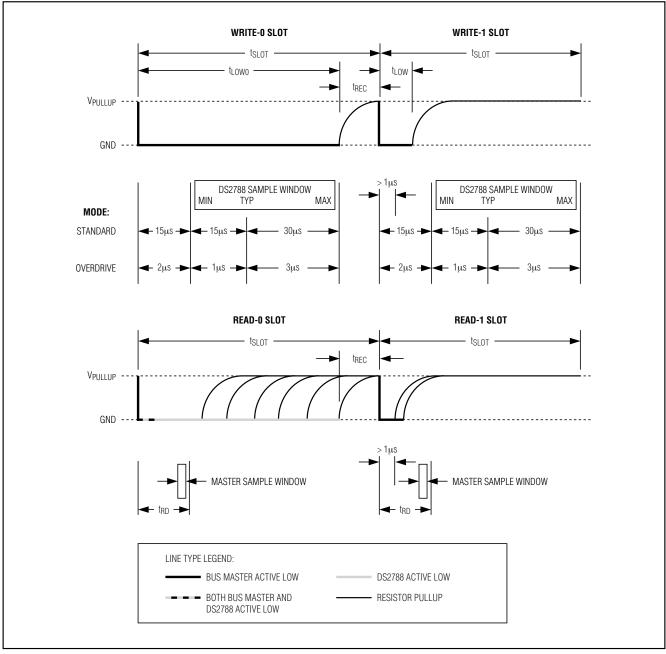
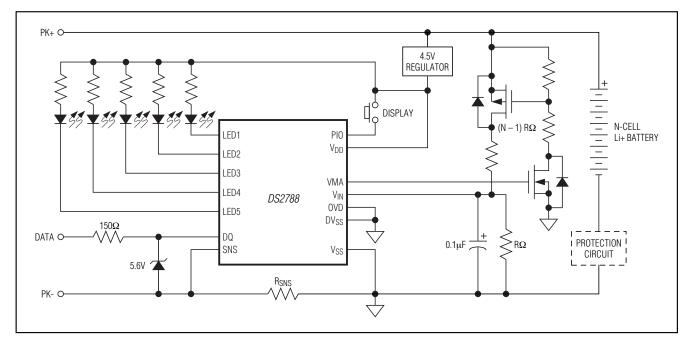


图27.1-Wire写时隙和读时隙

典型工作电路



## 封装信息

如需最近的封装外形信息和焊盘布局,请查询 china.maxim-ic.com/packages。

封装类型	封装编码	文档编号
14 TSSOP	U14+1	<u>21-0066</u>

修订历史

修订次数	修订日期	说明	修改页
0	10/07	最初版本。	—
1	6/08	在RAAC、RSAC、RARC和RSRC说明中增加了图14至图17。	17
2	5/09	将工作电压修改为最大4.5V。	2-4, 6, 7, 31

Maxim北京办事处

北京8328信箱 邮政编码100083 免费电话: 800 810 0310 电话: 010-6211 5199 传真: 010-6211 5299



Maxim不对Maxim产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利许可。Maxim保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。电气 特性表中列出的参数值(最小值和最大值)均经过设计验证,数据资料其它章节引用的参数值供设计人员参考。

Maxim Integrated 160 Rio Robles, San Jose, CA 95134 USA 1-408-601-1000